

ECE認定プログラム コース

要素技術コース

デバイスコース

要素プロセス技術1
リソグラフィコース

1	フォトマスク作製 レーザー描画
2	精密リソグラフィ 両面マスクアライナ
16	レジスト塗布 コータデベ
17	ナノインプリント

要素プロセス技術2
エッチングコース

7	シリコンドライエッチング D-RIE
8	ガラスドライエッチングNLD
12	ウエットエッチング
15	加工表面観察

要素プロセス技術3
成膜コース

13	パルレン薄膜形成 パルレン
14	金属薄膜形成1 ECRスパッタ
16	レジスト塗布 コータデベ
18	金属薄膜形成2 4元スパッタ

デバイス1
サーフェスマイクロマシニング
コース

(電極/配線形成)

2	精密リソグラフィ 両面マスクアライナ
12	ウエットエッチング ドラフト
14	金属薄膜形成1 ECRスパッタ
16	レジスト塗布 コータデベ

ECE認定プログラム

要素プロセス技術1, 2, 3, デバイスコース1

ECE認定基準

3/4以上受講

満たない場合、レポート(アンケート)提出

デバイスコース (イメージ)

実習はAu/Crスパッタ、フォトリソグラフィおよびウエットエッチングにより
金属電極を形成します。

